DESIGN AND FABRICATION OF THE S-BAND HIGH POWER DUMMY LOAD AND 3dB DIRECTIONAL COUPLER FOR KEKB INJECTOR

Yasuhito IGARASHI^{*}, Seiya YAMAGUCHI^{**}, Takao OOGOE^{**}, Zenzaburou KABEYA^{*} and Atsushi ENOMOTO^{**}

 * Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagoya Aerospace Systems 10, Oye-cho, Minato-ku, Nagoya, Aichi, 455
** KEK, High Energy Accelerator Research Organization 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305

Abstract

S-band high power dummy loads and 3dB directional couplers for the KEKB injector upgrade have been fabricated. The new dummy load using SiC was successfully operated at an input power of 7MW (4 μ sec,50pps,SLED-mode). Input VSWR of the new 3dB directional coupler has been improved from 1.10 to 1.02.

KEKB入射器用 S-バンド大電力無反射終端器

及び 3dB 方向性結合器の設計, 製作

1. はじめに

KEK では 1994 年度から 5 年計画で B ファクトリー計画 (KEKB)を開始した. これに伴い2.5GeV 電子ライナックを 8Gev に増強している. その増設部で用いる無反射終 端器及び 3dB 方向性結合器の製造を行った. 表 1 に 各々に要求される仕様を示す.

今まで使用してきた無反射終端器は、砲弾型 SiCを 吸収体として直接水冷しているが、SiC の破損による水 漏れ事故の心配がある.そのため、JLC 用に開発された 円柱状の SiC を用いた間接水冷型をもとに、コスト低減 のため、長さを半分にする等の改良を加え、KEKB 用 に再設計,製作した.

また, 3dB 方向性結合器については, 過去に製作された物について何台か測定した結果, VSWR が 1.10 近くあった. そのため設計を見直すことにした.

表 1-1 大電力無反射終端器の仕様.

周波数	2856 MHz
平均電力	1.2 kW
入力電力	6 MW
パルス幅	4 μ sec
繰り返し	50 pps
VSWR	1.1 以下
製作数 … 120 本	

裂作数 … 120 本

表 1-2 大電力 3dB 方向性結合器の仕様.

周波数	2856 MHz
VSWR	1.05 以下
相対位相角	$90 \pm 1^{\circ}$
電力分配比	$3.0 \pm 0.15 \text{ dB}$

製作数 … 45 台

- 2. 大電力無反射終端器の設計, 製作
- 2.1 主な特徴

新しく製作された大電力無反射終端器(以下, SiC ロ ート')の構造は,標準的な導波管(無酸素銅, 72.1mm ×34mm)の H 面に円柱状の SiC(20¢)をロー付けする. SiC は, SiCを固定した導波管の外側に水を流し,間接 水冷する. JLC用は28個のSiC プロックにより,平均電力 2.5kW(50MW, 1µsec, 50pps)に対して安定に動作する 能力を持っている.^[1~4]一方,KEKB入射器で使用す る SiC ロート'の仕様は表 1 に示したように,平均電力 1.2kWであり, JLC仕様の半分以下である. したがって, コスト低減のために長さを短くする等の改良を加えること にした.

2.2 低電力試験

反射係数及び電力減衰カーブは隣り合う SiC の間隔 (管内波長の約 1/4)と導波管内への突き出し量で決ま る. 突き出し量(初期値は電力がリニアに減少し,かつ 電力吸収は SiC の突き出し量に比例すると仮定して決 定した)の調整は,長さの異なる SiC を 15 種類用意し て並べる組み合わせを変え,間隔調整は間にスペーサを 出し入れした.使用する SiC の数はできるだけ少なく抑 えたいので7列×2(14個),8列×2(16個),9列×2(18 個)について行った.f = 2856MHz での VSWR が,1.05 以下となるよう調整した結果を図1に示す.9列×2(18 個)が全周波数にわたって VSWR が低いため,これを 採用した.図2にKEKB入射器用のSiCロードを示す.



図2 KEKB 入射器用 SiC ロード

軸方向電場分布は,非共振理論にもとずくビース、摂動法を用いて測定した(図3). 無理なくパワーが吸収されていることがわかる.





次に、SiC の複素誘電率(ε_r , tan δ)のばらつきがどの くらい VSWR に影響するのかを調べるために、4 台分 の SiC ブロック 72 個について測定を行った. その結果、 ε_r , tan δ の標準偏差が 4.51, 0.04, VSWR の標準偏差 は 0.01 であった. 一方量産に使用する SiC の内、440 個をサンプリングして ε_r , tan δ を測定し、標準偏差は、4.90, 0.05 となった(図 4). 偏差による VSWR への影響は、 少ないと思われる.



-129-

2.3 大電力試験

図 5 に示すようにライナックの 1 加速ユニットの回路を変 更して、大電力試験を行った.この加速ユニットは 40MW 級クライストロンと RF パルス増幅器 (SLED)を RF 源として持 ち、SLED から SiCロート までの排気は、751/sec のイオンポ ンプ Bと201/sec のイオンポンプ で行っている. 圧力は各イオ ンポンプ 近くの冷陰極電離真空計(CCG)で計測し、インタ ーロックには 751/sec 側の CCGを使用した.進行波及び反 射波の測定は SLED の前後に付いている ヘーテホールカプ ラー(60dB、70dB)で計測した.また SiCロート 前の H ヘン ト 導波管には観測用の窓を付けてあり、カメラで内部を 観測できるようにした.なお、この試験に使用した SiCロ ート の低電力時の VSWR は約 1.11 であった、

試験はまず SLED を離調した状態で行い,70 時間 程度で入力 1.4kW(7MW, 4µsec, 50pps)に達した. VSWR は約 1.14 であった.次に,離調棒を引き抜いて パルスを圧縮し,電力のピークを高めた状態で,再度電力 をせっから上げていった.約 40 時間で 1.4kW(7MW[ピ ーク電力 43MW], 4µsec, 50pps)に達した.その後 240 時間ほど連続運転をしたが,発光することもなく,圧力 は 2.1×10⁻⁶pa で安定していた.電力を入射しない場合 の圧力は, 1.9×10⁻⁶pa である. VSWRは約1.14であり, 低電力試験時の値より大きいが,これはパワーメーターや ベーテホールカプラーなどの誤差によるものと考えられる.



図5 大電力試験回路構成.

7月末現在, SiCロートは約50本ほど量産しているが, VSWRの平均は1.07となった.図8に1例を示す.



3. 3dB 方向性結合器の設計, 製作

既存の2.5GeVライナックで使用されている3dB方向性 結合器(以下, ハイブリッド)を図9に示す. B 改造では45 台製作するが,過去に製作されたもの(製作時期不明) について何台か測定した結果, VSWR が 1.10 近くあっ たため寸法を見直すことにした. 全長を変えてしまうと 立体回路全体の寸法に影響してしまうため、図 9 の d (チューニングボタンの深さ), t (ショートスロットの壁の厚み), L (ショートスロットの長さ)の3カ所について最適化を行うこと にした.まず, HP HFSS(High Frequency Structure Simulator)による数値計算を行った. d, t, L の長さを変 えて, port1でのVSWR≤1.05, port3-port2での位相差 90±0.5°, 電力差≤0.1dBとなるように追い込んでいっ た. 計算結果を図 10 に示す. 次にこの結果をもとに供 試体を製作し,確認することにした.供試体の寸法は,t, L については計算で求めた値を使い, d については深 さを0.1mm刻みで変えられるようにした. 試験結果を図 11に示す.実機の製作においては、最初の6台につい て供試体寸法を基準にボタンの深さを 20 通り用意し、 EBW 等による歪みの影響を測定して最終的な寸法を 決めた.7月末現在,ハイブリットは約15台ほど完成し, 測定結果の平均は以下の通りである.また VSWR 測定 の1 例を図 12 に示す.



図 10 HFSS での計算結果.



4. まとめ

無反射終端器及び3dB方向性結合器の設計, 製作 を行ったが, SiC ロードにおいては設計仕様を十分満た し, 最大入射電力でも安定に動作することがわかった. また SiC が脱落することもなく, ロー付けの信頼性も評価 できた. ハイブリットについても, 設計仕様を満たすことが できた.

5. 謝辞

JLC 用に開発された SiC ロードを KEKB 用に再設計 するにあたり, KEK の松本浩氏には多くの助言をして いだたきました.ここに厚くお礼を申し上げます.

参考文献

- [1] H. Matsumoto et al., "DEVELOPMENT OF S-BAND HIGH POWER RF LOAD". 第 16 回リニアック技術研究会, 1991.
- [2] S. Morita al., "DEVELOPMENT OF S-BAND HIGH POWER RF LOAD (II)". 第 17 回リニアック技術研究会, 1992.
- [3] S. Morita et al., "DEVELOPMENT OF S-BAND HIGH POWER RF LOAD (皿)". 第 18 回リニアック技術研究会, 1993.
- [4] S. Morita et al., "DEVELOPMENT OF S-BAND HIGH POWER RF LOAD (IV)". 第 20 回リニアック技術研究会, 1995.